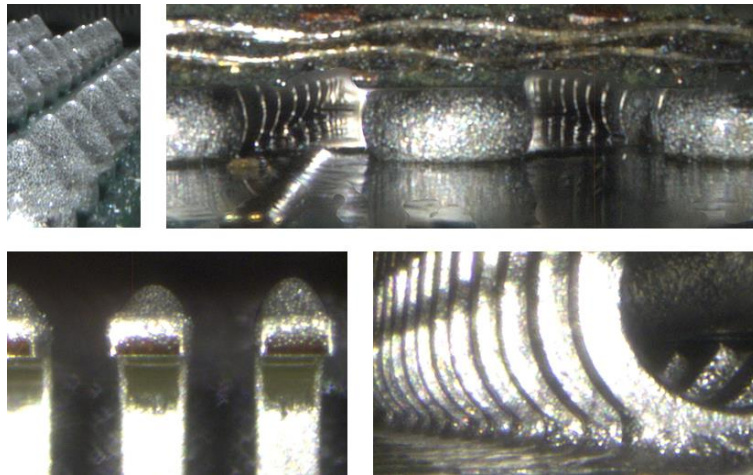


Produktbeschreibung

Dip Paste ist eine aktivierte bleifreie no clean Lotpaste geeignet für den Auftrag durch Dippen. BGA-Bauteile bzw. Bauteile mit Gull Wing Anschlüssen oder ähnlichen lassen sich durch definiertes Eintauchen in die Lotpaste gezielt mit Lot und Flussmittel beschicken. Im Vergleich zum Dispensieren ist beim Dippen eine erhebliche Zeitersparnis gewährleistet. Zudem ist wegen der geringeren Menge an aufgetragener Lotpaste und damit auch von Lot die Gefahr der Brückenbildung zwischen den Anschlüssen deutlich kleiner. Durch das Auftragen von Lot wird außerdem die Gefahr von kalten Lötstellen minimiert, die z.B. durch Unplanaritäten verursacht werden können. Die Eintauchtiefe beim Dippen ist durch die geometrischen Gegebenheiten des Bauteils bestimmt, das Bauteil selbst darf keinen Kontakt zur Dip Paste bekommen.



Gedippte Lotpaste (jeweils links) und anschließend gelötete Bauteile (rechts)

ELSOLD Dip Paste bietet

- Gute Benetzung auf den üblichen metallischen Oberflächen
- Optimale Dosierung
- Hohe Aktivität auf allen Substraten
- Lange Offenzeit
- Gute Klebrigkeit
- Flussmittelklassifizierung J-STD-004: ROL1
- Geeignet für alle Lötverfahren mit indirekter Erwärmung

Zuverlässigkeitseigenschaften

Klebrigkeit > 8 h

Lotkugel-Test: bestanden

IPC-TM 650, Methode 2.4.43

Kupferspiegeltest: L

IPC-TM-650, Methode 2.3.3

Silber-Chromat-Papiertest: bestanden

IPC-TM-650, Methode 2.3.35.1

Isolationswiderstand

J-STD-004, IPC-TM-650, Methode 2.6.3.3

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Ungereinigt nach 24 h: | $9.6 \times 10^8 \Omega$ |
| Ungereinigt nach 96 h: | $1.0 \times 10^9 \Omega$ |
| Ungereinigt nach 168 h: | $1.0 \times 10^9 \Omega$ |
| Kontrollbord nach 24 h: | $1.1 \times 10^{10} \Omega$ |
| Kontrollbord nach 96 h: | $1.2 \times 10^{10} \Omega$ |
| Kontrollbord nach 168 h: | $1.2 \times 10^{10} \Omega$ |

Technische Produktinformation

ELSOLD Bleifreie No Clean Dip Lotpaste SAC305

Physikalische Eigenschaften

Daten für SAC305, 75 % Metall, Pulvertyp 5: 10 – 25 µm **Viskosität:** 350 – 450 Pa·s

| Legierung | Sn [%] | Ag [%] | Cu [%] | Schmelzpunkt [°C] |
|----------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| Sn96,5Ag3Cu0,5 | 96,5 ± 0,5 | 3,0 ± 0,2 | 0,5 ± 0,2 | 219 |

Anwendung

Die ELSOLD Dip Lotpaste wird durch Eintauchen der Anschlüsse in die Paste aufgetragen. Die Eintauchtiefe kann durch Schablonendruck mit der Stärke der Eintauchtiefe festgelegt werden oder durch Programmieren der Eintauchtiefe mit einer Reworkmaschine eingestellt werden.

Dip Paste enthält sehr feines Lotpulver. Daher ist es wichtig, die Paste vor Gebrauch auf Raumtemperatur zu erwärmen. Nach Gebrauch die Dose wieder gut verschließen. Auf keinen Fall benutzte Paste wieder zurück in die Dose geben.

Verpackung

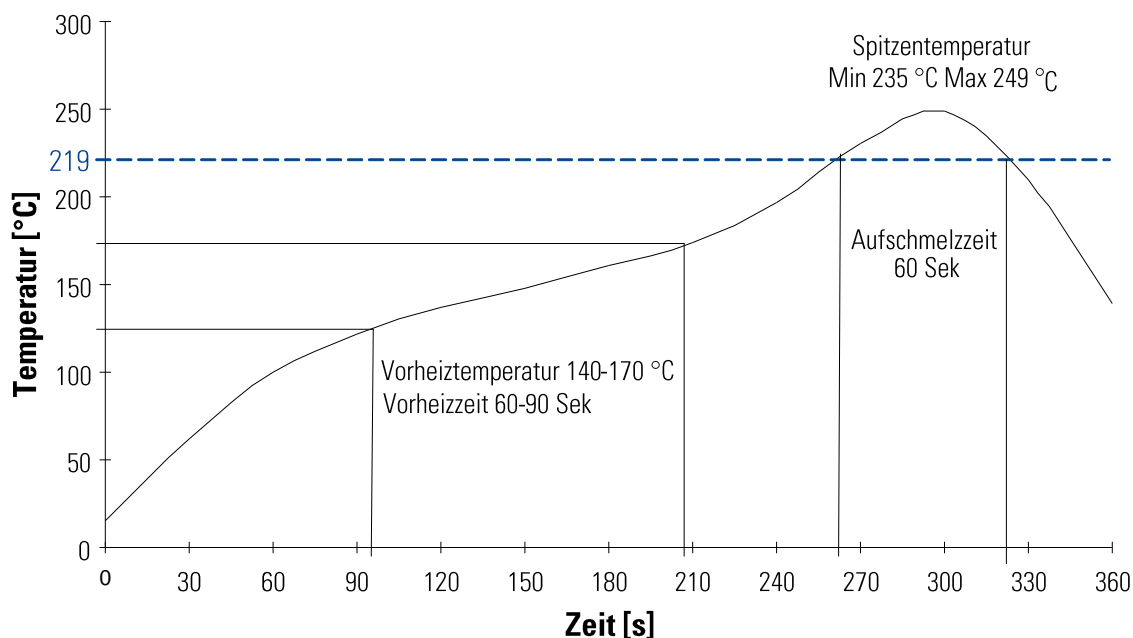
Stülpedeckeldosen mit Innenschieber: 250 g und 500 g. Andere Verpackungen auf Anfrage.

Lagerung

Dosen: maximal 6 Monate im geschlossenen Originalbehälter bei 6 – 16 °C.

Reflowprofil

Das dargestellte Temperaturprofil kann als Ausgangspunkt für eigene Profilloptimierungen dienen.



Vorstehende Angaben sollen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit oder Gewährleistung kann jedoch aufgrund der Vielseitigkeit der Materialien, der Anwendungen, auch bezüglich der Schutzrechte Dritter, nicht übernommen werden.